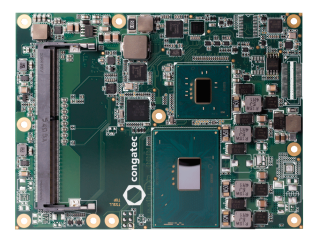
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Contact presse :** |
| **congatec AG** | **NEXTUAL** |
| Christian Eder | Pascale Desmaele |
| Phone: +49-991-2700-0 | Tél : 06 11 48 30 36 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | [pascale@nextual.fr](mailto:pascale@nextual.fr)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**congatec présente des Modules-Serveurs   
équipés des nouveaux processeurs Intel® Xeon®/Core**

****

*Les nouveaux modules COM Express de congatec   
affichent des performances de classe Serveur.*

Paris - 2 novembre 2015 -- congatecAG, acteur de premier plan dans le domaine des modules processeurs embarqués, des cartes SBC (mini-ITX) et des services EDM, élargit sa gamme COM Express Basic avec de nouveaux modules embarqués de classe Serveur. Ces nouveaux server-on-modules sont équipés de la 6e génération de processeurs Intel Xeon et Intel Core i3/i5/i7 (nom de code Skylake). La mémoire DDR4 des modules conga-TS170 fournit jusqu'à deux fois plus de performance mémoire système pour les applications intensives en données, tout en consommant 20% d'énergie en moins et en occupant moitié moins de place qu'une RAM DDR3. De plus, les modules offrent des processeurs plus rapides, un bus système accéléré de 60% et une mémoire Intel Smart Cache étendue (jusqu'à 8 Mo), ainsi que la prise en charge de PCIe 3.0 pour toutes les voies PCIe et le nouveau Intel HD Graphics P530. Au final, les utilisateurs pourront bénéficier de meilleures performances systèmes et d'une densité globale accrue, avec moins d'espace occupé et moins d'énergie consommée.

Les nouveaux modules ont été développés pour des projets embarqués de classe Serveur fonctionnant à l'intérieur d'une enveloppe thermique de TDP situé entre 25 et 45 W et nécessitant des E/S et des interfaces IoT personnalisées. Les nouveaux modules conga-TS170 équipés des processeurs Intel Core conviennent parfaitement aux applications de tests et de mesure, aux systèmes back-end dans l'imagerie médicale, aux stations industrielles de hautes performances et aux distributeurs automatiques intelligents.

Les variantes du module Intel Xeon offrent en outre de la mémoire ECC qui permet une utilisation dans des applications de serveurs et de passerelles critiques au niveau des données. On trouvera ces applications dans l'internet des objets industriel et les serveurs cloud avec de l'analyse big data, les nœuds de serveurs télécoms ainsi que les serveurs d'automatismes connectés Industry 4.0 hébergeant de multiples machines virtuelles ou des serveurs multimédia avec plusieurs flux de transcodage vidéo en temps réel.

De plus, les nouveaux modules conga-TS170 apportent des outils puissants pour gérer les applications partagées IoT, M2M et Industry 4.0. Grâce à la technologie Intel® vPro et au contrôleur de gestion de la carte de congatec avec watchdog timer et contrôle de perte de puissance, les modules sont parfaitement équipés pour des tâches de surveillance, administration et maintenance à distance.

Pour des applications économiques et qui ne requièrent pas nécessairement de très haute performance telle que la virtualisation, les modules basés sur le processeur Intel Core i3 et le chipset Mobile Intel HM170 sont également disponibles.

**Les fonctionnalités en détail**

Les nouveaux modules conga-TS170 sont équipés de la 6e génération de processeurs Xeon v5 et Intel Core en 14 nm. Ils possèdent un TDP de 25-45 W, jusqu'à 8 Mo de cache intelligent et de la mémoire DDR4 2133 super rapide jusqu'à 32 Go, implantée en tant que mémoire ECC pour des applications de sécurité dans les variantes Intel Xeon et Core i3. Pour un fonctionnement basse consommation 24/7, les nouveaux modules prennent en charge une attente déconnectée à la place du mode traditionnel S3. Avec une dormance déconnectée, le passage en mode veille basse consommation pour obtenir de pleines performances prend moins d'une demi seconde ; ainsi, les systèmes peuvent se mettre en mode veille plus souvent sans nuire à l'accessibilité et à la réactivité.

La 9e génération Intel HD Graphics 530 intégré prend en charge DirectX 12 pour des traitements graphiques 3D sous Windows 10 plus rapides sur 3 écrans 4K indépendants (3840 x 1260) via HDMI 1.4, DVI ou DisplayPort 1.2. Pour les applications standards, une sortie LVDS double canal et en option une sortie VGA sont disponibles. Grâce au support intégré dans le silicium du décodage ainsi que de l’encodage HEVC, VP8, VP9 et VDENC, il est désormais possible d'avoir des flux vidéo HD en basse consommation dans les deux directions.

En plus de PCI Express Gen 3.0 Graphics (PEG), le choix des interfaces d'E/S disponibles comprend : 8 voies PCI Express Gen 3.0, 4 USB 3.0, 8 USB 2.0, LPC et I2C. Le stockage SSD, HDD et BluRay peut être connecté via 4 SATA 3.0 y compris un support RAID 0, 1, 5, 10. Un ensemble complet d'accessoires pour faciliter le design, comme des solutions de refroidissement, des cartes porteuses et des kits de démarrage, complètent l'offre.

**Liste des processeurs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processor** |  | **Cores** |  | **Smart Cache [MB]** |  | **Clock [GHz]** |  | **Turbo Boost [GHz]** |  | **TDP [W]** |  | **graphics** |
| **Intel® Core™  i7-6820EQ** |  | **4** |  | **8** |  | **2.8** |  | **3.5** |  | **45** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i7-6822EQ** |  | **4** |  | **8** |  | **2.0** |  | **2.8** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i5-6440EQ** |  | **4** |  | **6** |  | **2.7** |  | **3.4** |  | **45** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i5-6442EQ** |  | **4** |  | **6** |  | **1.9** |  | **2.7** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i3-6100E** |  | **2** |  | **3** |  | **2.7** |  | **-** |  | **35** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™  i3-6102E** |  | **2** |  | **3** |  | **1.9** |  | **-** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Xeon®  E3-1505M v5** |  | **4** |  | **8** |  | **2.8** |  | **3.7** |  | **45 / 35** |  | **Intel® HD Graphics P530** |
| **Intel® Xeon®  E3-1505L v5** |  | **4** |  | **8** |  | **2.0** |  | **2.8** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics P530** |

Une data sheet et des informations complémentaires sur les nouveaux modules conga-S170 sont disponibles sur : <http://www.congatec.com/products/com-express-type6/conga-ts170.html>.

**A propos de Congatec**

Congatec AG, dont le siège est situé à Deggendorf, Allemagne, est un fournisseur de premier plan de modules processeurs industriels utilisant les standards Qseven, COM Express, XTX et ETX, de cartes SBC et de services EDM. Les produits de Congatec peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente.

Parmi les compétences et le savoir-faire technique de Congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets. Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits de Congatec sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. La société possède des filiales à Taiwan, au Japon, Chine, USA, Australie et République Tchèque. Site web : [www.congatec.com](file:///C:\Users\desmaele\AppData\Local\Microsoft\desmaele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\desmaele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\A0UKGA4I\www.congatec.com) ou via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

\* \* \*

*Intel and Intel Xeon, Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*